

### 附件 3：“半导体装备系统软件班”报名表

|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| <b>申<br/>请<br/>人</b>                   | 姓名：  | 出生日期：            年    月    日 |
|  | 性别：  | 政治面貌：                        |
|  | 学号：  | 研究生类别（A、学术型 B、专业型）：          |
|  | 研究方向：  | 指导教师：                        |
|  | 本科院校：  | 本科专业：                        |
|  | 联系电话：  | 电子邮箱：                        |
| <b>意<br/>向<br/>实<br/>习<br/>岗<br/>位</b> | <p>请从《附件 1：实习岗位》中选填最多 2 个意向岗位</p> <p>岗位 1：</p> <p>岗位 2：</p> <p>*如填写了某个意向岗位，则默认同意根据录取情况前往该岗位实习。</p> <p>*最终录取岗位将根据选填岗位志愿顺序、该岗位报名及面试情况确定。</p> |                              |
| <b>导<br/>师<br/>审<br/>核<br/>意<br/>见</b> | 导师签字：<br>年    月    日   |                              |
| <b>学<br/>院<br/>审<br/>核<br/>意<br/>见</b> | 学院盖章：<br>年    月    日   |                              |

(限 1000 字以内，主要介绍学习工作经历，前期科研学术成果，后附证明材料)

个人简介

本人签字：